

深南电路股份有限公司

2025 年度财务预算报告

一、行业格局及发展趋势

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1984 年，始终专注于电子互联领域，经过四十余年的深耕与发展，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项主营业务。公司已成为中国电子电路行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联特色企业，系国家火炬计划重点高新技术企业、电子电路行业首家国家技术创新示范企业和国家企业技术中心、中国电子电路行业协会（CPCA）理事长单位及标准委员会会长单位。

目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放 PCB 供应商、内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。根据 Prismark 报告，预计 2024 年公司营收规模在全球印制电路板厂商中位列第 4。

1、印制电路板（含封装基板）行业发展情况

根据 Prismark 2024 年第四季度报告统计，2024 年以美元计价的全球 PCB 产业产值同比增长 5.8%，其中 18 层及以上多层板、HDI 增速明显高于行业水平，主要得益于算力、高速网络通信和新能源汽车及 ADAS 等下游领域呈高景气，带动 PCB 产业相关产品需求保持较高增长；在宏观经济温和复苏、行业库存周期性回补的背景下，4-6 层板、8-16 层板、封装基板等产品的需求缓慢修复。中长期层面，PCB 产业延续高频高速、高精密度、高集成化等发展趋势，18 层及以上的高多层板、HDI 板、封装基板未来五年复合增速预计保持相对较高水平，分别为 15.7%、6.4%、7.4%。从区域分布看，未来五年全球各区域 PCB 产业仍呈增长态势，其中，中国大陆地区复合增长率为 4.3%。

2024-2029 年 PCB 产业发展情况预测（按产品类别）

单位：百万美元

类型/年份	2023	2024E		2029F	2024-2029F
	产值	产值	同比	产值	复合增长率
纸基板/单面/双面板	7,757	7,947	2.4%	9,149	2.9%
4-6 层板	15,434	15,736	2.0%	17,661	2.3%
8-16 层板	9,375	9,837	4.9%	12,192	4.4%
18 层板及以上	1,726	2,421	40.3%	5,020	15.7%
HDI	10,536	12,518	18.8%	17,037	6.4%
封装基板	12,498	12,602	0.8%	17,985	7.4%
柔性板	12,191	12,504	2.6%	15,617	4.5%
合计	69,517	73,565	5.8%	94,661	5.2%

数据来源：Prismark 2024 Q4 报告

2024-2029 年 PCB 产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

类型/年份	2023	2024E		2029F	2024-2029F
	产值	产值	同比	产值	复合增长率
美洲	3,206	3,493	9.0%	4,075	3.1%
欧洲	1,728	1,638	-5.3%	1,863	2.6%
日本	6,078	5,840	-3.9%	7,855	6.1%
中国大陆	37,794	41,213	9.0%	50,804	4.3%
亚洲（日本、中国大陆除外）	20,710	21,382	3.2%	30,063	7.1%
合计	69,517	73,565	5.8%	94,661	5.2%

数据来源：Prismark 2024 Q4 报告

2、电子装联行业发展状况

电子装联处于 EMS 行业，狭义上指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前全球 EMS 行业的市场集中度相对较高，国际上领先的 EMS 厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外的服务能力。电子装联行业供应链较为复杂，涉及包括 PCB、芯片、主被动元件等在内的各种电子元器件，故供应链更容易受到上游零件短缺的冲击，因此供应链能力已成为电子装联行业的核心竞争力之一。此外，EMS 行业随着人工智能、大数据等新技术应用场景的多元化和应用深化，客户需求更加多样化、个性化，且新技术新产

品迭代和更新频率加快，对于 EMS 厂商的柔性制造能力、服务响应速度、辅助设计与后端检测服务能力也提出了更高要求。

综上所述，2024 年以来，在人工智能的强劲推动以及产业下游库存回补需求的双重作用下，全球电子产业整体需求呈现出稳步增长的态势。其中，AI 算力相关的硬件需求以及汽车电动化/智能化趋势，成为行业增长的主要驱动力。

二、公司发展战略

公司将持续专注于电子互联领域，围绕“3-In-One”战略，发挥业务协同优势将核心业务做强做优做大，全面提升各业务技术、质量及运营能力，加速业务融合发展，发挥公司电子互联产品技术平台优势，推进转型升级，打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商，成为受全球领先客户认可的电子互联技术领导者。

三、2025 年经营计划

从宏观层面看，根据 IMF 最新发布的 2025 年全球经济展望，预计 2025 年全球经济增速为 3.2%，增速基本持平，经济增长依然面临挑战。电子产业受益于全球 AI 技术的飞速发展及应用深化，仍将主要围绕算力、汽车等相关领域延续下游需求。预计 2025 年公司业务所处下游市场存在结构性机会。

公司 2025 年将继续坚持“3-In-One”战略，积极把握人工智能快速发展带来的市场机会，同时持续加强运营管理工作，推动公司实现高质量增长。一方面，公司继续加强各业务高端产品线能力建设，推进新项目产能建设及爬坡；另一方面，通过持续提升产品线竞争力、提升运营效率、加强交付保障等举措，支撑各项业务实现预期目标。

PCB 业务 2025 年将继续聚焦战略目标客户的开发突破与目标产品的导入，增强国际化的市场拓展能力；进一步提升各专业产品线的技术、成本、质量管理能力和准时交付能力，围绕目标产品构建技术能力平台，满足客户对新产品开发的需求；继续夯实运营能力，进一步提升质量管理水平，强化成本竞争力。

封装基板业务 2025 年将重点把握半导体市场目标产品需求的复苏机会，继续推进战略目标客户开发与关键项目落地；加快 FC-BGA 产品线竞争力建设，支撑广州项目顺利爬坡。

电子装联业务 2025 年将继续以数据中心、汽车等市场领域为重点，并持续深耕通信、工控、医疗等领域；以运营、技术、供应链等为抓手，通过强化辅助设计与增值服务能力，更好地服务客户需求，持续加强电子装联业务的综合竞争力。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十二日